技术条款响应一览表

配置序号	配置名称	详细技术参数要求	数量	备注
1	切割工作台	工作台尺寸：≥1200mm×900mm; ***切割范围：≥1200mm×650mm;** Z/Y 轴行程：≥700mm/≥600mm; Z/Y 轴导轨直线度≤20μm@全行程; Z/Y 轴导轨副定位精度：≤25μm@全行程; Z/Y 轴导轨副重复定位精度：≤15μm@全行程; 床身和立柱材料：天然花岗岩	2	
2	金刚石线刀盘系统	主轴 1 回转精度（第一主动线轮）：≤3μm; 主轴 2 回转精度（第二从动轮）：≤3μm; 切割缝宽度：≤1mm; 切割线速度：0～50m/s; 切割进给速度：0.1mm/min～10mm/min; ***平面度：≤0.2mm/300mm;** ***切割尺寸精度：≤0.02mm;** 断线保护功能：有;	2	
3	两维角度调整工作台	旋转 C 轴运动范围：360° 俯仰 B 轴运动范围：±4°（水平面为 0°） ***旋转/俯仰定位精度：＜45″;** 旋转重复定位精度：≤20″; 俯仰重复定位精度：≤25″。	2	
4	数控系统要求	控制系统：采用国产数控系统。	2	
5	切削液冷却系统	***切削液控温精度要求为不超过±1℃;**	2	
6	晶体定向精密测角模块	***定向精度：≤30″** 2θ扫描范围：- 10°~140°; 2θ 角重复精度≤0.001°; 扫描速度：0.006~20°/min; 测量准确度：≤0.008°; 最小步进角度：0.001°; 探测器高压稳定性：优于±0.005%; 计数器：闪烁计数器; 计数线性范围：≥700000 cps; 计数器电压：0~2100V 连续可调; 背景噪声≤1cps;	1	

		标准片：材料为二氧化硅，外形25mm*25mm*5mm，定轴精度≤20″； 控制软件：中文界面，能自动控制衍射仪系统做连续/阶梯扫描，具备数据采集、自动保存等功能，可控制测角仪步进/步退； 工控机:CPU主频≥3.0GHZ ,内存≥16G，硬盘≥1TB。		
7	X 光衍射测量光源	***样品尺寸范围：≥600mm×600mm；** 功率：≥2KW； 衍射形式：单衍射； X 射线管：铜靶，阳极接地，电压10KV-500KV ，电流调节范围 5mA-40mA，自动光闸控制管压、管流升降，具备高温断电等保护； 高频电源变压器：输出电压运 50KV ，波动范围为士 0.05% ，具有防漏外壳、接线柱等保护； 控制器：手自一体控制器，内嵌机壳安装，调节范围，可近距离触屏控制及远端通讯控制，超电压、电流保护，水冷却等保护； 防护：X 光出口光闸连锁保护，全封闭贴铅外壳。	1	